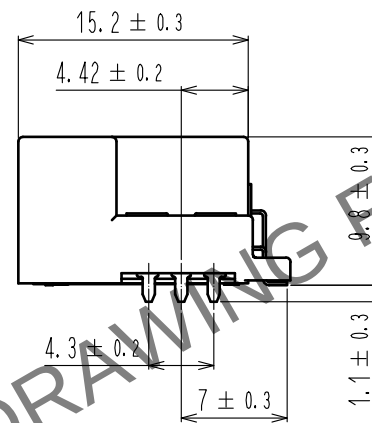
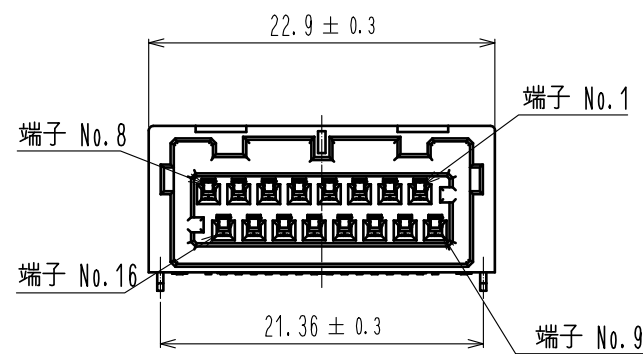
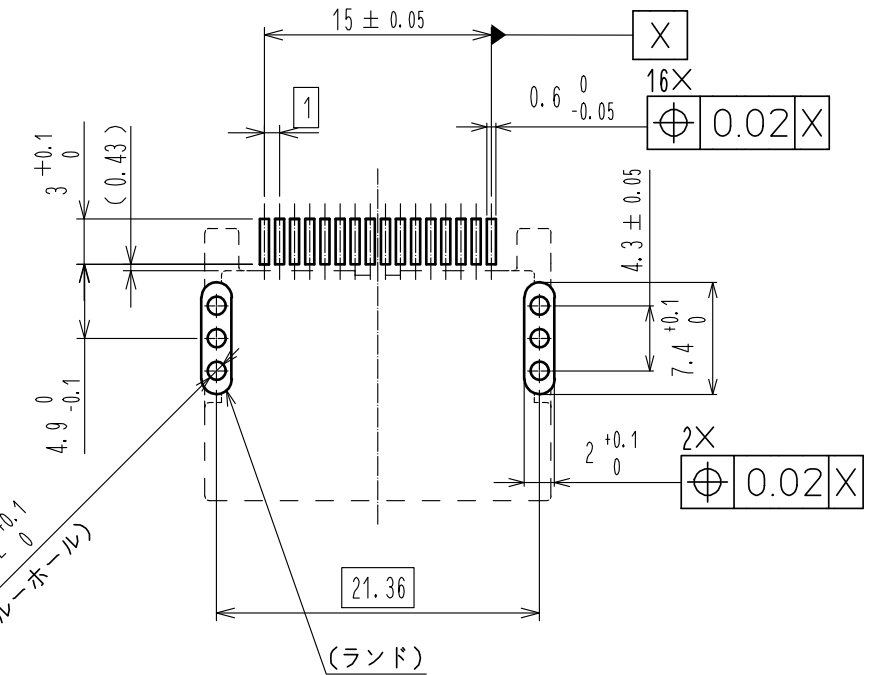
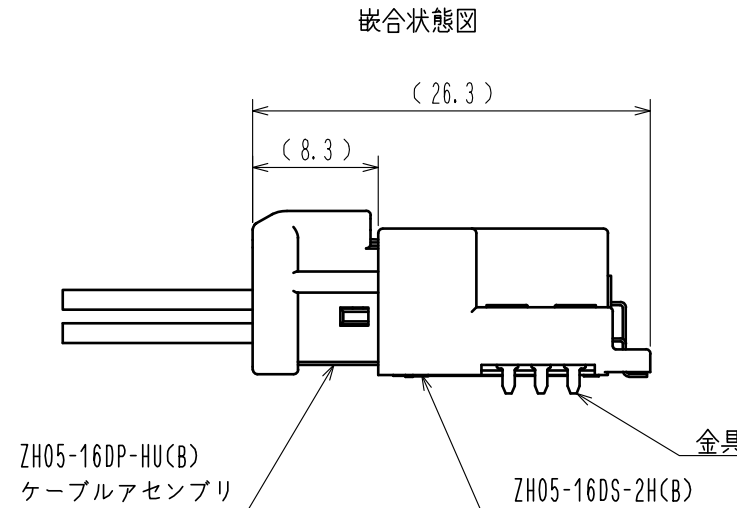
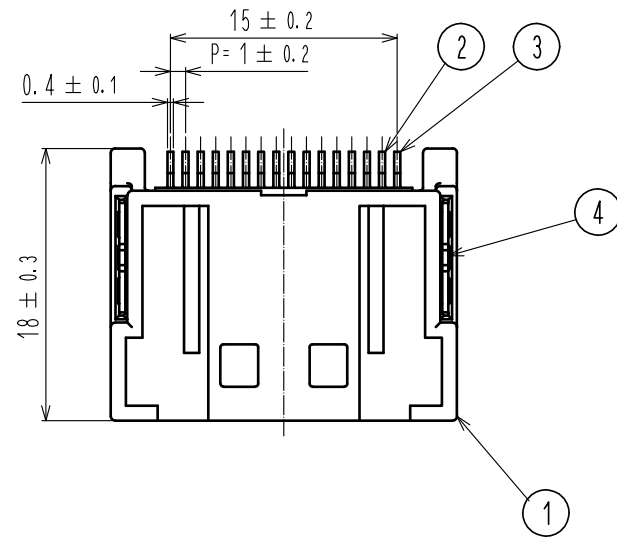


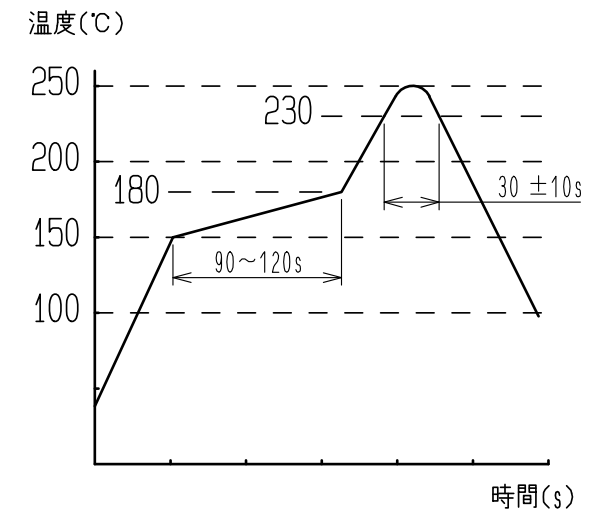
May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV, RoHS 適合品

推奨基板寸法図 (FREE)
(基板厚: $t=1.6\text{mm}$, メタルマスク厚: $t=0.1\text{mm}$)



- 注 1. 推奨温度プロファイル (右表参照)
使用リフロー加熱方式
: 遠赤外線、エア大気中または窒素中
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
90~120s



2. 手ハンダ/ハンダこて温度
: 280-300℃, 2S 以内
3. 端子平坦度は0.1mm 以下とする。
4. 推奨基板厚は $T=1.6\text{mm}$ とする。
5. 推奨はんだ厚は0.10mmとする。
6. 実装時の状況により、実装部の温度上昇が抑えられはんだが熔融しない場合がございます。
その際、はんだを熔融させるためにリフロー温度を上昇させると、
ハウジングに250℃以上の過剰な熱が加わりプリスターが発生する恐れがございます。
実装時はハウジング表面が250℃を超えないことをご確認をお願いいたします。

3	銅合金	表面: すずめっき $1\mu\text{m min}$	6	ポリエステル	
		下地: ニッケルめっき $1\mu\text{m min}$			
2	銅合金	表面: すずめっき $1\mu\text{m min}$	5	ポリスチレン	
		下地: ニッケルめっき $1\mu\text{m min}$			
1	PA	グレー, UL94V-0	4	黄銅	表面: すずめっき $1\mu\text{m min}$
					下地: ニッケルめっき $1\mu\text{m min}$
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT		DESCRIPTION OF REVISIONS
		APPROVED : AH. EDASHIGE CHECKED : TY. MOGI DESIGNED : AN. SAIKI DRAWN : AN. SAIKI		DESIGNED	
				CHECKED	
				DATE	
				DRAWING NO.	
				PART NO.	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		20230111		ADC-389970-00-00	
				ZHO5-16DS-2H(B)	
		20230110		CODE NO.	
				CL0756-2104-0-00	
		20221215		1/2	

	DRAWING NO. ADC-389970-00-00		
	PART NO. ZH05-16DS-2H(B)		
	CODE NO. CL0756-2104-0-00		